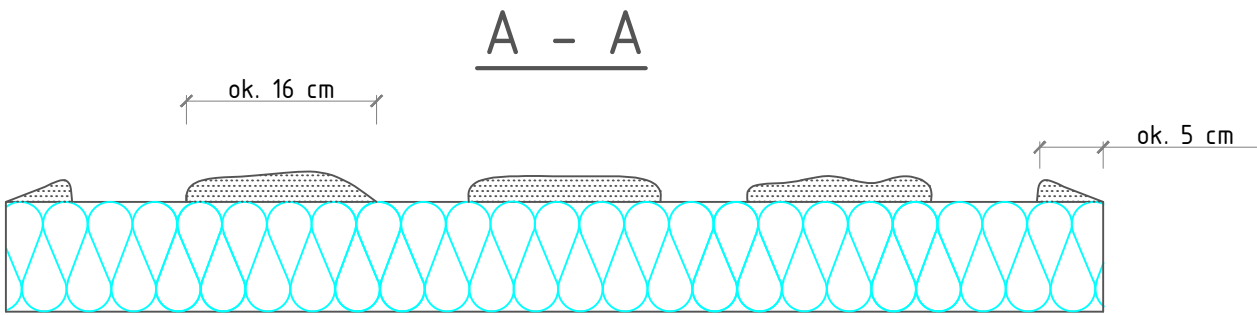
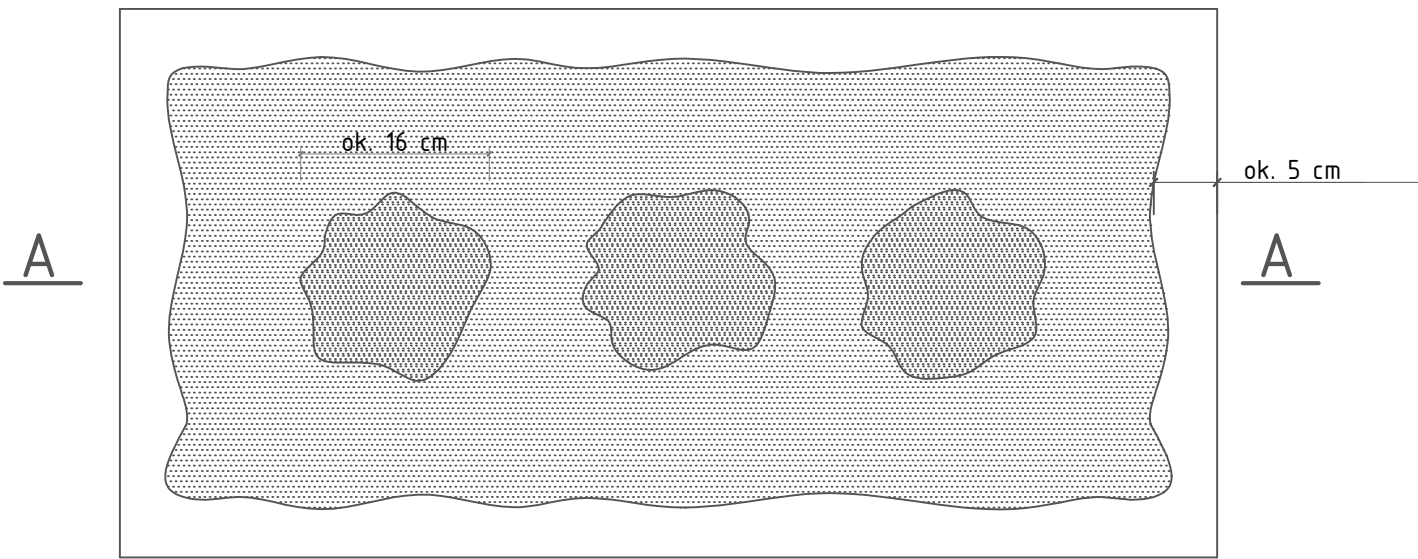
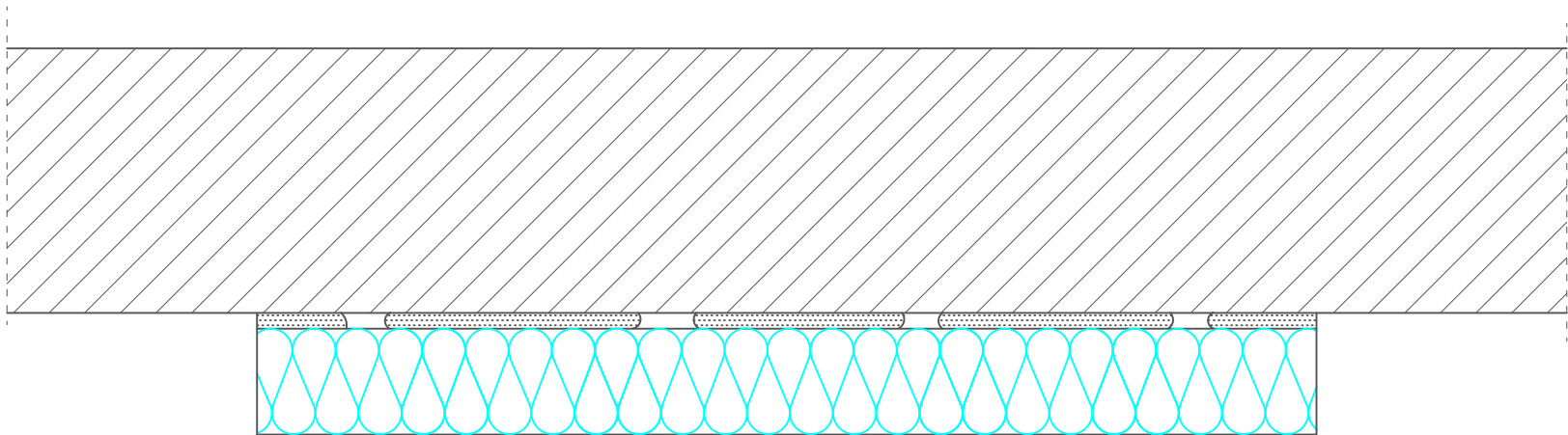


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej
przylegająca do ściany

Uwagi :

Do klejenia izolacji termicznej używa się zapraw klejowych do mieszania z wodą na budowie. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża. Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

<div>Dąbrowka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-89-56 IDS 240318331</div> <div>MPprojekt</div>	TEMAT ZADANIA	Termomodernizacja budynku pawilonu H w zakresie docieplenia i montażu instalacji fotowoltaicznych			
	OBIEKT ADRES	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY Al. Piłsudskiego 11, 18-404 ŁOMŻA PAWILON H			
	TEMAT RYS.	DETAL KLEJENIA PŁYTY IZOLACJI TERMICZNEJ			
	ARCHITEKTURA - PROJEKTANT	mgr inż arch. Beata Struzik nr upr. 107/98		DATA	30.04.2024
	ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY	mgr inż arch. Robert Kucharski nr upr. 4/02/SLOKK		SKALA	BS
				NR RYS.	16